

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

隆扬电子（昆山）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-012

活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 _____
参与单位名称	国投证券苏州分公司机构部 沈健 天琛私募基金 王海平 增长龙品牌咨询 陈小龙 上海永松健律师事务所 黄金生 上海知恒律师事务所 赵芳 苏州培恩企业管理咨询 蒋国炎 中财招商投资集团 吴锋 苏州市名物文化发展有限公司 刁昇全 浙江安桥私募基金 刘凯 上海高谨资产管理有限公司 胡晓俊 北极星咨询 赵文祥 正平股份上海分公司 孙昊 (以上排名不分先后)
时间	2025 年 11 月 12 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 金卫勤 证券事务代表 施翌

主要内容介绍	公司证券事务代表向与会人员介绍了公司概况、发展布局、公司重大事项，董事长秘书同与会人员进行了问答交流，本次交流主要内容如下： Q1、公司第三季度的经营情况能不能简单介绍一下？ 公司第三季度实现营收 2.912 亿元，同比增长 39.54%，实现归母净利润 8172 万元，同比增长 55.19%。 Q2: 公司并购的两家企业和公司的协同作用主要体现在哪些地方？ 两个并购标的与本公司隶属同一行业，具有显著的协同效应。通过本次收购，未来将优化供应链管理，有效降低公司生产成本。其次，两个标的公司均具备深厚的技术积累和创新能力，其研发团队将显著增强公司自研体系的核心竞争力，进一步加强公司国产替代的能力。最后，客户端的差异性可以促进各自的产品互通，客户互融，进一步拓展现有客户群体。在通过本次收购可实现优势互补与资源协同，同时亦将保持业务端的独立运营体系，以并行发展模式释放协同价值，推动业绩提升。 Q3、公司三季报货币资金减少的主要原因是什么？ 主要因素是公司以现金支付的形式并购常州威斯双联 51%的股权及苏州德佑新材 70%的股份。 Q4、公司铜箔产品有什么优势？目前铜箔产品的进程和送样情况是什么样的？ （1）公司通过自有核心技术研发的 HVLP5 高频高速铜箔，具有极低的表面粗糙度且具备高剥离力的特点，未来可主要应用于 AI 服务器等需要高频高速低损耗的应用场景。 （2）公司已向中国（大陆及台湾地区）和日本的多头部覆铜板厂商（CCL 厂）送样，HVLP5 铜箔正在配合下游客户验证推进中。目前，公司第一个细胞工厂已完成建设，设备陆续装机中。
附件清单（如有）	无
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的	公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄

说明	露等情况。
日期	2025 年 11 月 12 日